

■ 特殊バンプ

特長

- ・ 高さ : $250\mu\text{m}$ / トップ径 : $100\mu\text{m}$
- ・ 安定したコンタクト性能
- ・ 設計の自由度が向上
- ・ BVH 接続
- ・ ファイン化が容易で、コストダウン提案可能

仕様・構造

銅バンプ $\phi 400\mu\text{m}$ PSR 開口 ($800\mu\text{m}$ ピッチ)

PSR

〈1段バンプ〉

製品例

1段バンプ

高さ : $250\mu\text{m}$
 トップ : $300\mu\text{m}$
 ボトム : $350\mu\text{m}$
 ランド : $600\mu\text{m}$
 ピッチ : $800\mu\text{m}$

2段バンプ

高さ下段 : $150\mu\text{m}$
 高さ上段 : $100\mu\text{m}$
 トップ : $100\mu\text{m}$
 ボトム : $350\mu\text{m}$
 ランド : $600\mu\text{m}$
 ピッチ : $800\mu\text{m}$

〈用途例〉 BGA への直接コンタクト

■ 極細 FPC

特長

- ・ 基板幅 0.3mm 以下が可能
- ・ 狭いところにも配線可能
- ・ 筐体に巻き付けることでスプリングのように使用することが可能

製品例

Line/Space = $20\mu\text{m}/20\mu\text{m}$

$300\mu\text{m}$
(6本配線)

〈用途例〉 カテーテル代替として・医療機器の狭いスペースへのケーブル用途に

■ 透明基板

特長

- ・ 透明なので筐体のデザインを損ねない
- ・ 光を透過させることが可能
- ・ ポリイミドなので部品実装が可能



〈用途例〉 医療用装置で使用する基板としてデジタルサイネージ

基板の向こう側が視認出来るためピンポイントで対象物に合わせることが可能

超極薄

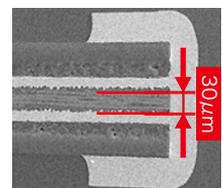
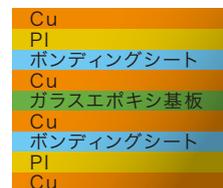
リジッド基板使用多層板 (要相談)

特長

- ・ コア層に超極薄リジッド基板を使用 ($25\mu\text{m} \sim 30\mu\text{m}$)
- ・ 超極薄化対応
- ・ 高寸法安定性

製品例

仕様・構造



〈用途例〉 通信機器 計測機器